

「ノイズと熱の対策は構想設計段階が決め手！」

製品設計におけるノイズと熱の最新アプローチ手法

【概要】

設計者を悩ます見えない敵、ノイズと熱の問題は試作しないとわからないと思っていませんか？本セミナーでは、ギガヘルツテクノロジー株式会社様のご協力を得て、ノイズと熱の問題を設計初期段階で解決するための手法を、サムスンテックワイン様、株式会社リコー様のユーザ事例を交えながらわかりやすくご紹介いたします。

事後対策によるコストや納期で悩んでいる経営者や設計者の皆さん、必見です！

- ◆開催日時：2013年6月21日（金）
13:00～16:45（12:30より受付開始）
- ◆開催場所：TKP大手町カンファレンスセンター16階 16B会議室
- ◆対象：
 - ・設計改革をお考えの経営者層の方
 - ・製品の熱・PI（パワーインテグリティ）問題でお困りの方
 - ・熱設計・ノイズ設計を始めてみたい方
 - ・ソリューションによる解決を目指している方
- ◆定員：100名（先着順）※定員に達し次第、締め切らせていただきます。
- ◆参加費用：無料
- ◆申込期限：2013年6月14日（金）



お申込みはホームページより
<http://www.zsas.co.jp/>

Agenda

13:00～13:10	ご挨拶	株式会社ジーサス 代表取締役社長 宮原 省吾
13:10～14:10	基調講演 サムスンに見るイノベーション	2000年以降急速な成長を遂げまた更に成長を続けるサムスン電子。 その成長を支えるイノベーションの原動力は何か、また強い製品開発力を維持する設計イノベーションは何かを長年技術指導に携わった講演者の視点でご紹介します。 サムスンテックワイン 先行技術研究所 技術顧問/博士 浜村 博史 様
14:10～14:40	リコーにおけるノイズ設計の取り組み事例	株式会社リコー WS開発本部 第二開発室 開発1G 小屋 大輔 様
14:40～14:55	休憩	
14:55～15:20	電源ノイズ設計のフロントローディング	ギガヘルツテクノロジー株式会社 代表取締役社長 河村 隆二 様
15:20～15:30	Zsasにおける活用事例	株式会社ジーサス 設計技術サービス部長 山本 英明
15:30～16:30	熱対策から熱設計へ～製品設計におけるエネルギー問題とその対策	株式会社ジーサス 热設計ソリューション部長 藤田 哲也
16:30～16:45	質疑応答	
17:00～19:00	懇親会 (22B会議室) ※22Fへご移動ください。	お飲み物とお食事をご用意しております。お気軽にご参加ください。

◆会場地図



東京メトロ丸の内線・東西線・千代田線・半蔵門線・都営三田線 『大手町』駅C1出口直結！
『東京駅』丸の内北口から徒歩9分

◆TKP大手町カンファレンスセンター

住所：〒100-0004 東京都千代田区大手町 1-8-1 KDDI大手町ビル16F,22F
TEL：03-3243-5231

■講師略歴■

浜村 博史(はまむら ひろふみ)

1970年慶應義塾大学工学部電気工学科卒業 1970年富士通に入社。
以来一貫してコンピュータ開発畑にてメインフレームやスーパコンピュータ、サーバなどの
大型汎用コンピュータ並びにマイクロプロセッサ関連の設計自動化システムの研究開発に従事。
2004年より韓国サムスン電子の技術顧問として全社設計基盤の構築および開発革新関連の
技術指導に従事し現在に至る。情報理工学博士(東京大学) 情報処理学会システムLSI設計
技術委員会主査、電子情報通信学会VLSI設計技術専門 委員会委員長ほか各種国内および
国際会議などの委員歴任。

主な著書:デジタルシステムの自動設計(共訳、産業図書)、電子装置のCAD(共著、情報処理学会叢書)ほか